

证券代码：300456

证券简称：赛微电子

北京赛微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：2025-004

投资者关系活动类别	☒特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 ☐业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☒现场参观 ☐其他
参与单位名称及人员姓名	华福证券 罗通
时间	2025 年 8 月 5 日 15:30-18:00
地点	北京经济技术开发区科创八街 21 号院 赛微电子北京 MEMS 产业基地五楼会议室
上市公司接待人员姓名	董事、总经理、董事会秘书：张阿斌 证券投关高级经理：刘妍君 证券投关专员：甘世延
投资者关系活动主要内容介绍	第一部分：公司介绍 上市公司介绍了公司的基本情况、发展历程、核心业务、产业角色、全球化布局、发展战略、商业模式、竞争格局等。赛微电子专注 MEMS 芯片制造主业，持续提升境内外产线的产能利用率及良率。公司看好万物互联与人工智能背景下智能传感芯片行业的未来发展空间，同时对自身的 MEMS 芯片制造工艺及综合竞争实力充满信心。 公司组织安排了北京 FAB3 产线洁净间参观活动。 第二部分：上市公司解答提问，主要如下： 1、公司如何看待 MEMS 行业的纯代工模式及 IDM 模式？

	答：在我们看来，每家公司的业务发展模式都是根据自身的业务情况确定的，公司非常尊重各类厂商（包括客户）自身的战略考虑。但同时我们也应看到，半导体制造产线的建设具有长周期、重资产投入的特点，且某单一领域设计公司投资建设的自有产线一方面较难为同类竞争设计公司服务，另一方面产线向其他产品品类拓展的难度也较大。而公司是专业的纯代工企业，基于长期的工艺开发及生产实践，在同类产品的代工业务方面能够积累较好的工艺技术，在制造环节具有产品迭代和成本控制方面的服务优势，Fabless（无晶圆厂）模式或 Fablite（轻晶圆厂）设计公司与我们合作，可以避免巨大的固定资产投资，可以将资源更多地专注在产品设计及迭代方面，并参与市场竞争。 综合而言，IDM 模式与 Fabless 或 Fablite 模式（对应与纯 Foundry 厂商合作）相比各有优劣，将会是业界长期共存的商业发展模式。 2、近年来 MEMS 行业的整体增速并不高，请问公司如何看待 MEMS 行业未来的市场规模？ 答：随着万物互联与智能传感时代的到来，物理世界与数字世界需要相互连接的桥梁，无论科技及应用如何发展，均离不开对真实世界的感知，人、设备、自然世界之间及内部各自之间的感知、联系均需要通过声、热、光、电、磁、运动等等各种基础器件来辅助实现，基础感知及执行器件的应用场景将越来越丰富，通过半导体工艺批量标准化制造的 MEMS 芯片，具备小型化、低成本、低功耗、高集成度等突出特点，正在对部分传统传感器件进行渗透及替代。我们认为，基于“软硬件一体配比”的逻辑，相比 IC 芯片产业的规模体量，MEMS 芯片产业仍处于发展初期，未来发展前景广阔。
--	--

	3、请问 MEMS 行业当前的发展情况及竞争格局如何？ 答：随着万物互联与人工智能的兴起，作为集成电路细分行业的 MEMS 获得了更广阔的市场空间和业务机会。传统的传感器、执行器和无源结构器件逐步被替代，MEMS 技术的渗透率得以进一步提高。根据世界权威半导体市场研究机构 Yole Development 发布的《Status of the MEMS Industry 2025》，全球 MEMS 市场规模将由 2024 年的 154 亿美元增长至 2030 年的 192 亿美元，CAGR（年均复合增长率）达到 3.7%。 MEMS 行业 Foundry 模式与 IDM 模式并存，代工企业通过支持 Fabless、Fab-lite 设计公司快速创新，推动 MEMS 生态发展。公司非常突出的特点在于，公司是国内业界领先、极少数以 Pure-Foundry 模式运营的 MEMS 芯片专业制造厂商，包括其他商业模式下的竞争对手包括台积电、芯联集成、华鑫微纳、广州增芯、上海先进、华虹宏力、华润微、士兰微等。 截至目前，不同 MEMS 应用领域的竞争格局存在不同差异，通信计算、生物医药、工业汽车和消费电子领域的中高端市场已经开始出现国产替代，未来具有广泛发展空间。 总体来看，MEMS 行业正处于关键发展期，技术开发、工艺创新及新材料应用水平是影响企业核心竞争力的关键因素，公司在 MEMS 产业链中拥有清晰的角色定位及充分的发展定力。 4、请问公司转让全资子公司瑞典 Sillex 控制权的原因？ 答：公司决策并快速执行瑞典 Sillex 控制权的出售，具有特定的国际政经环境背景考虑，是一项务实、共赢的举动，有助于为瑞典 Sillex 寻求更稳定的经营环境，使其能够有效应对国际政治环境变化带来的经营不确定性，能够促进其业务进一步增长，最大限度维护上市公司利益，避免潜在价值减损风险；同时，公司仍保留了瑞典 Sillex 约 45%股份，能够持续获取稳定
--	--

	投资收益，并保留了参与重大事项决策的权利。 因此，本次交易是公司面临海外业务经营环境发生重大变化情形下的最优应对方案，有利于最大程度维护上市公司及全体股东的利益。 5、公司将如何使用股权出让款？后续公司将如何定位瑞典 Silex？将如何开展后续合作？ 答：关于本次股权出售所获资金，公司将谨慎并高效使用，以支持公司核心主业的发展及在半导体综合服务领域的中长期布局。瑞典 Silex 的控股关系发生变化后，公司后续将探索境内外资源可能的协作路径，为公司的业务布局及发展提供持续稳定支撑。瑞典 Silex 的新控股股东拥有悠久历史、强大实力，公司与新控股股东、管理层均保持了良好的沟通及合作关系，公司支持出表之后的瑞典 Silex 与公司及控股子公司开展各方面的合作。 6、2024 年，公司 MEMS 业务毛利率整体保持稳定，瑞典产线与北京产线的产品结构有何差异？毛利率有何区别？ 答：瑞典产线运营了超过 20 年，产品及客户类别丰富，工艺开发业务占比较高，且由于折旧摊销压力较小，MEMS 业务的整体毛利率高于仍比较“年轻”的北京产线。虽然 MEMS 晶圆制造业务在当前阶段的毛利率较低，但北京产线 MEMS 工艺开发业务的毛利率却并不必然低于瑞典产线。MEMS 产线的工艺、运营状况及毛利率水平，本质上取决于市场订单需求。基于智能传感时代多点迸发的基础器件需求以及国产替代的时代背景，公司对北京产线业务的毛利率水平持有信心。 7、北京 MEMS 产线的产能利用率仍处于较低水平，公司对此有何规划？
--	---

	答：与 IC 产线的标准化流程不同，MEMS 产线涉及晶圆类别众多、工艺及材料纷繁复杂。对于公司北京 FAB3 产线，随着硅麦克风、BAW 滤波器、MEMS 微振镜、MEMS 高频器件等产品的量产爬坡，以及 MEMS 气体、生物芯片、加速度计、惯性 IMU、温湿度、硅晶振等产品的风险试产，以及 MEMS 压力、微流控、红外、硅光子等产品的工艺开发推进，随着客户及订单需求持续增加，公司需要做的是充分重视工艺及良率，特别关注保障产能爬坡过程中的一致性 & 稳定性，推动产能利用率的持续提升，华山一条路，别无捷径。 另外，由于 MEMS 行业高度定制化、验证试产之后才有量产的客观规律，MEMS 产线的产能利用率一般低于 CMOS 产线，同时在一定时期往往存在“产能等待订单”的状态。公司客观看待北京 MEMS 产线所处发展阶段，既理解短期较低的产能利用率水平，又对中长期产能利用率的持续提高充满信心。 8、请介绍 MEMS 市场需求变化及对公司产品结构的影响？ 答：整体而言，MEMS 行业拥有来源丰富、活跃变化的市场需求。公司服务的客户包括硅光子、激光雷达、运动捕捉、光刻机、DNA/RNA 测序、高频通信、AI 计算、ICT、红外热成像、计算机网络及系统、社交网络、新型医疗设备厂商以及通信计算、生物医药、工业汽车和消费电子各细分行业的领先企业，能够为公司 MEMS 业务的持续发展提供巨大的发展潜力。 北京 FAB3 继续处于产能爬坡阶段，具有导入属性的工艺开发业务继续开展，量产属性的晶圆制造业务进一步夯实发展。公司参股子公司瑞典 FAB1&FAB2 的订单、生产与销售状况良好。 9、请问贵公司北京 FAB3 的新增产能如何进行消化？公司未来的发展规划是怎样的？
--	--

	答：北京 FAB3 已实现产能 1.5 万片/月，正在分阶段向 3 万片/月产能扩充，并持续扩大晶圆类别及客户领域，尤其是具备量产潜力的领域及产品。MEMS 产能规划具备特殊之处，需要重视平衡产能投建的前瞻性与风险性。MEMS 产品由于种类众多、高度定制、部分产品导入验证周期长，因此与标准化 IC 产品按订单扩产不同，公司需要有针对性地先于订单落实投建产能，以保障未来客户需求的及时响应与工艺能力的持续升级。 截至目前，北京 FAB3 已实现硅麦克风、BAW 滤波器、微振镜、超高频器件的量产，正在进行小批量试产气体、生物芯片、惯性加速度计、惯性测量单元（IMU）、温湿度、硅晶振等 MEMS 器件，同时对于压力、硅光子、MEMS-OCS、3D 硅电容、PMUT（压电微机械超声波换能器）、喷墨打印头、磁性传感器、红外等 MEMS 芯片、器件及模块，正积极从工艺开发向验证、试产、量产阶段推进。北京 FAB3 将继续密切关注市场环境动态，深化全国重点区域布局，注重分析产品在不同应用领域的特点，持续提升运营能力。 除持续提升北京 FAB3 产能和工艺能力外，公司还在怀柔等地布局 MEMS 中试线建设，可为北京 FAB3 积累和导入早期客户。通过上述举措，公司得以向客户提供多类产品流片服务，加快形成从工艺开发到晶圆制造的一体化服务能力，打造具备高度定制化服务能力、同时具备量产能力及竞争力的 MEMS 工艺平台。
附件清单(如有)	无
日期	2025 年 8 月 5 日